

SD480

有机硅电子凝胶

特点

- ◇ 双组分，1: 1混合
- ◇ 低粘度
- ◇ 室温固化或者加热快速固化
- ◇ 加成型固化，无固化副产物
- ◇ 自修复性。
- ◇ 对大材料的压敏粘结多数
- ◇ -50℃~200℃ 保持弹性
- ◇ 优异的电性能
- ◇ 符合 RoHS

典型应用

- ◇ 对纯度很高的电子产品有长效的防潮和防大气污染保护
- ◇ 精密电器线路以及混合电路的保护，小型电器的灌封保护

典型数据

固化之前（加成型固化）

A 组分

外观	透明液体
密度, g/cm ³	0.97
25 °C 粘度, mPa. s	450

B 组分

外观	透明液体
密度, g/cm ³	0.97
25 °C 粘度, mPa. s	450

固化

按照重量比或者体积比 1: 1 混合

25 °C 粘度, mPa. s	450
25 °C 下工作时间, 分钟	60
25 °C 下固化时间, 小时	8-16
50 °C 下固化时间, 分钟	45
130 °C 下固化时间, 分钟	7

固化后

150 °C 下 滤纸上 测试24小时
油离渗透, mm 4.5

体积热膨胀系1/K 9.6×10^{-4}

电性能, 150 ° C下固化1小时

击穿电压 kV/mm 15
体积电阻 Ohm. cm 3.0×10^{15}

- 1, 确认被保护材料清洁干燥
- 2, 确认两个组份按照体积比或者重量比1: 1混合, 建议真空(10-20mm汞柱)下抽5-10分钟
- 3, SD480按照推荐比例混合后, 在室温下2个小时后粘度将翻倍, 我们称之为工作时间
- 4, 操作时尽量避免带入空气, 对复杂外形的线路板建议真空灌封

使用

特别注明

在使用SD480的过程中, 特别注意不要和以下物质接触, 否则会导致产品固化不完全或者甚至不固化

- 有机锡
- 含有机锡的有机硅产品
- 含硫的物质
- 胺基, 聚胺脂, 酰胺及叠氮化物

修复性

SD480具有良好的可修复性, 对其自身也有很好的压敏粘结性, 所以修复粘结的材料和整体可以保持一致

通常 SD480 采用 18kg+18kg 包装。

包装

储存和保质期

室温储存

SD480 在没有开封的状态下可以有 24 个月的有效保质期

安全

请参考产品的物质安全系数表

本文中的资料是依据我们现有知识的真实表示。它仅仅是一种指标, 并不承担使用我们产品时侵害或损害第三方权益的连带责任。

欧赛尔(苏州)新材料有限公司保证该产品符合其销售规格。

备注

本产品资料决不能在进行必需的测试前作为替代品时使用, 该测试是唯一能保证某产品适合于指定的用途。

用户应负责保证遵守当地法规并获得必需的证书和认可。

用户应复核他们拥有的该产品的资料是最新的版本, 欧赛尔(苏州)新材料有限公司可按他们的要求来提供任何附加的资料。

欧赛尔(苏州)新材料有限公司